

Title (en)
Semiconductor power module

Title (de)
Leistungshalbleitermodul

Title (fr)
Module semi-conducteur de puissance

Publication
EP 0845809 A2 19980603 (DE)

Application
EP 97810842 A 19971110

Priority
DE 19649798 A 19961202

Abstract (en)
In a power semiconductor module (1) with a housing (2) covering a base plate (5) which carries one or more chips (6) and contact lines (7) for connecting the chips to an external connection (8) and to each other, a layer of foam (9) is positioned within the housing below the housing cover (3).

Abstract (de)
Es wird ein Leistungshalbleitermodul angegeben, bei dem im Gehäuse unter dem Gehäusedeckel eine Lage Schaumstoff angeordnet ist. Der Schaumstoff ermöglicht nicht nur eine mechanische Stützung der Vergussmasse, so dass eine Ablösung derselben verhindert wird, sondern kann auch einen grossen Druckanstieg im Falle eines Kurzschlusses durch Komprimierung aufnehmen. Auf diese Weise wird ein Ausgleichsvolumen geschaffen, ohne dass das Gehäuse zerstört wird. Das Gehäuse bleibt geschlossen und es wird kein Material in die Umgebung geschleudert.
<IMAGE>

IPC 1-7
H01L 25/065; **H01L 23/24**

IPC 8 full level
H01L 23/24 (2006.01); **H01L 25/07** (2006.01); **H01L 25/16** (2006.01); **H01L 25/18** (2006.01)

CPC (source: EP US)
H01L 23/24 (2013.01 - EP US); **H01L 25/072** (2013.01 - EP US); **H01L 25/165** (2013.01 - EP US); **H01L 24/48** (2013.01 - EP US); **H01L 2224/48091** (2013.01 - EP US); **H01L 2224/48227** (2013.01 - EP US); **H01L 2924/00014** (2013.01 - EP US); **H01L 2924/0102** (2013.01 - EP US); **H01L 2924/01068** (2013.01 - EP US); **H01L 2924/13055** (2013.01 - EP US); **H01L 2924/16152** (2013.01 - EP US); **H01L 2924/181** (2013.01 - EP US); **H01L 2924/19107** (2013.01 - EP US)

Cited by
EP1868242A3; EP0921565A3; WO2009062534A1; US11450621B2; WO2008031370A1; WO2019185268A1; US8283763B2; US8304889B2

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0845809 A2 19980603; **EP 0845809 A3 20000503**; DE 19649798 A1 19980604; JP H10163417 A 19980619; US 5977621 A 19991102

DOCDB simple family (application)
EP 97810842 A 19971110; DE 19649798 A 19961202; JP 32435197 A 19971126; US 93511097 A 19970929